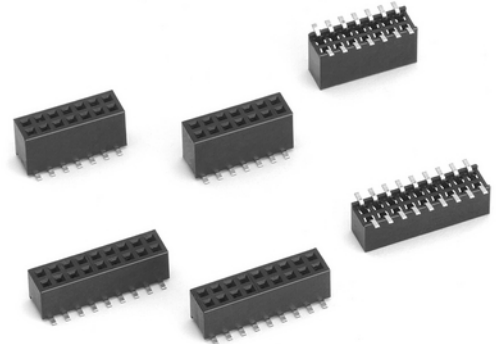


## SMT Buchsenleisten RM 1,27mm - durchsteckbar SMT Female Header Pitch 1,27mm - Bottom Entry

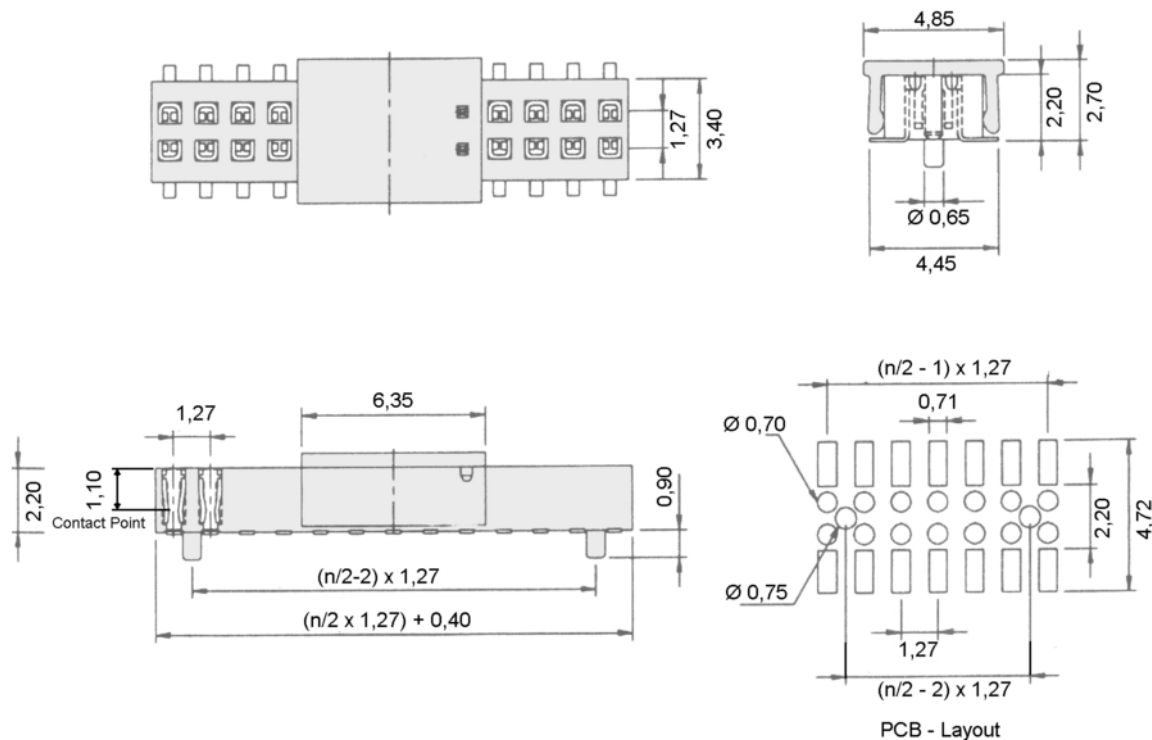
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1,3 ... 2,5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC512-12A <i>IEC512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 10 <sup>9</sup> Ω <i>&gt; 10<sup>9</sup>Ω</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub> <i>500V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T <i>Reflow-soldering, detailed information in ch. T</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Stiftleisten Serie:  
Mates with Pin Headers Series:  
**7072 / 7075 / 7073**



Series	Contacts*	Plating*	Locating Peg*	Packing*
<b>6061</b>	<b>040</b> 010-100 Zweireihig Double row	<b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated	<b>10</b> 00 Ohne Positionierhilfe W/o locating peg 10 Mit Positionierhilfe With locating peg	<b>PPST</b> 00 ST PPST PPTR

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

#### Lieferformen / Packing Options:

**00** = Schüttgut ohne PP-Pad / Bulk good w/o PP-Pad  
**ST** = In Stangen ohne PP-Pad / In tubes w/o PP-Pad  
**PPST** = In Stangen mit PP-Pad / In tubes with PP-Pad  
**PPTR** = Tape & Reel mit PP-Pad / Tape & Reel packing with PP-Pad

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX.: +49 5223 98507-50

# W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com  
INTERNET: www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Information

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte)

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{S_{max}}$ to $T_p$ )	3°C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{S_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{S_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-180 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{S_{max}}$ to $T_p$ )	3°C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{S_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{S_{max}}$ ) - Time ( $t_{S_{min}}$ auf $t_{S_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-180 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak-Temperature ( $t_p$ )	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:

